

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年4月7日(07.04.2022)



(10) 国際公開番号

WO 2022/070503 A1

(51) 国際特許分類:
C09J 11/04 (2006.01) H01L 21/52 (2006.01)
C09J 163/00 (2006.01) C09J 7/35 (2018.01)
C09J 171/12 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2021/020043

(22) 国際出願日: 2021年5月26日(26.05.2021)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2020-163561 2020年9月29日(29.09.2020) JP

(71) 出願人: 古河電気工業株式会社(FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1008322 東京都千代田区大手町二丁目6番4号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 森田 稔(MORITA, Minoru); 〒1008322 東京都千代田区大手町二丁目6番4号 古河電気工業株式会社内 Tokyo (JP). 坂井 小雪(SAKAI, Koyuki); 〒1008322 東京都千代田区大手町二丁目6番4号 古河電気工業株式会社内 Tokyo (JP). 綿引 慶太(WATAHIKI, Keita); 〒1008322 東京都千代田区大手町二丁目6番4号 古河電気工業株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 特許業務法人イイダアンドパートナーズ, 外(IIDA & PARTNERS et al.); 〒1050004 東京都港区新橋3丁目1番10号 石井ビル3階 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: TRANSPARENT ADHESIVE COMPOSITION, FILM-LIKE TRANSPARENT ADHESIVE, METHOD FOR MANUFACTURING TRANSPARENT ADHESIVE CURED LAYER-PROVIDED MEMBER, AND ELECTRONIC COMPONENT AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME

(54) 発明の名称: 透明接着剤用組成物及びフィルム状透明接着剤、並びに、透明接着剤硬化層付部材の製造方法、電子部品及びその製造方法

(57) Abstract: The present invention pertains to: a transparent adhesive composition which contains an epoxy resin (A), an epoxy resin curing agent (B), and a phenoxy resin (C), and in which the epoxy resin curing agent (B) satisfies (1) and (2); a film-like transparent adhesive obtained by processing said composition; and a method for manufacturing a transparent adhesive cured layer-provided member, a method for manufacturing an electronic component, and an electronic component, all of which using said film-like transparent adhesive. (1) Being a powder and having a particle diameter (d90) at a cumulative distribution frequency of 90% of 2.0 μm or less. (2) Having a solubility of 0.1 g or less with respect to 100 g of methyl ethyl ketone at 25°C.

(57) 要約: エポキシ樹脂 (A)、エポキシ樹脂硬化剤 (B)、及びフェノキシ樹脂 (C) を含有し、前記エポキシ樹脂硬化剤 (B) が下記 (1) 及び (2) を満たす透明接着剤用組成物、これを加工してなるフィルム状透明接着剤、並びにフィルム状透明接着剤を用いる、透明接着剤硬化層付部材の製造方法、電子部品の製造方法、及び電子部品。(1) 粉体状であり累積分布頻度90%時の粒径(d90)が2.0 μm以下(2) 25℃においてメチルエチルケトン100gに対する溶解度が0.1g以下

WO 2022/070503 A1